

中国集成电路封装产业态势观察及十三五投资环境分析报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国集成电路封装产业态势观察及十三五投资环境分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/232624232624.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

集成电路封装在电子学金字塔中的位置既是金字塔的尖顶又是金字塔的基座。说它同时处在这两种位置都有很充分的根据。从电子元器件（如晶体管）的密度这个角度上来说，IC代表了电子学的尖端。但是IC又是一个起始点，是一种基本结构单元，是组成我们生活中大多数电子系统的基础。同样，IC不仅仅是单块芯片或者基本电子结构，IC的种类千差万别（模拟电路、数字电路、射频电路、传感器等），因而对于封装的需求和要求也各不相同。本文对IC封装技术做了全面的回顾，以粗线条的方式介绍了制造这些不可缺少的封装结构时用到的各种材料和工艺。

中国报告网发布的《中国集成电路封装产业态势观察及十三五投资环境分析报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

报告大纲：

第一章：中国集成电路封装行业发展背景

1.1集成电路封装行业定义及分类

1.1.1集成电路封装行业定义

1.1.2集成电路封装行业产品大类

1.1.3集成电路封装行业特性分析

（1）行业周期性

（2）行业区域性

（3）行业季节性

1.1.4集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析

1.2集成电路封装行业政策环境分析

1.2.1行业管理体制

1.2.2行业相关政策

（1）《电子信息产业调整和振兴规划》

（2）发改委加大对集成电路行业的支持力度

（3）科技部重点支持集成电路重点专项

（4）《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

（5）海关支持软件产业和集成电路产业发展有关政策规定和措施

1.3集成电路封装行业经济环境分析

1.3.1国际宏观经济走势分析及预测

(1) 国际宏观经济走势分析

(2) 国际宏观经济走势预测

1.3.2国内宏观经济走势分析及预测

(1) 国内宏观经济走势分析

(2) 国内宏观经济走势预测

1.4集成电路封装行业技术环境分析

1.4.1集成电路封装技术演进分析

1.4.2集成电路封装形式应用领域

1.4.3集成电路封装工艺流程分析

1.4.4集成电路封装行业新技术动态

第二章：中国集成电路产业发展分析

2.1集成电路产业发展状况

2.1.1集成电路产业链简介

2.1.2集成电路产业发展现状分析

(1) 行业发展势头良好

(2) 行业技术水平快速提升

(3) 行业竞争力仍有待加强

(4) 产业结构进一步优化

2.1.3集成电路产业区域发展格局分析

(1) 三大区域集聚发展格局业已形成

(2) 整体呈现“一轴一带”的分布特征

(3) 产业整体将“有聚有分，东进西移”

2.1.4集成电路产业面临的发展机遇

(1) 产业政策环境进一步向好

(2) 战略性新兴产业将加速发展

(3) 资本市场将为企业融资提供更多机会

2.1.5集成电路产业面临的主要问题

(1) 规模小

(2) 创新不足

(3) 价值链整合不够

(4) 产业链不完善

2.1.6集成电路产业“十三五”发展预测

2.2集成电路设计业发展状况

2.2.1集成电路设计业发展概况

2.2.2集成电路设计业发展特征

- (1) 产业规模持续扩大
- (2) 企业数量不断增长
- (3) 企业规模持续扩大
- (4) 技术能力大幅提升

2.2.3集成电路设计业发展隐忧

2.2.4集成电路设计业新发展策略

2.2.5集成电路设计业“十三五”发展预测

2.3集成电路制造业发展状况

2.3.1集成电路制造业发展现状分析

- (1) 集成电路制造业发展总体概况
- (2) 集成电路制造业发展主要特点
- (3) 2015年集成电路制造业规模及财务指标分析

1) 2015年集成电路制造业规模分析

2) 2015年集成电路制造业盈利能力分析

3) 2015年集成电路制造业运营能力分析

4) 2015年集成电路制造业偿债能力分析

5) 2015年集成电路制造业发展能力分析

2.3.22013-2015年集成电路制造业经济指标分析

- (1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素
- (2) 2013-2015年集成电路制造业经济指标分析
- (3) 2013-2015年不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析
- (4) 2013-2015年不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析
- (5) 2013-2015年不同地区企业经济指标分析

2.3.32013-2015年集成电路制造业供需平衡分析

(1) 2013-2015年全国集成电路制造业供给情况分析

1) 2013-2015年全国集成电路制造业总产值分析

2) 2013-2015年全国集成电路制造业产成品分析

(2) 2013-2015年全国集成电路制造业需求情况分析

1) 2013-2015年全国集成电路制造业销售产值分析

2) 2013-2015年全国集成电路制造业销售收入分析

(3) 2013-2015年全国集成电路制造业产销率分析

2.3.4集成电路制造业“十三五”发展预测

第三章：中国集成电路封装行业发展分析

3.1 半导体行业发展分析

3.1.1 半导体行业指数对比分析

- (1) 费城半导体指数与道琼斯指数
- (2) 台湾电子零组件指数与台湾加权指数
- (3) CSRC电子行业指数与沪深300指数

3.1.2 全球半导体产销分析

- (1) 全球半导体产值情况
- (2) 全球半导体销售情况

3.1.3 全球半导体行业主要企业情况

- (1) 2015年全球半导体10强
- (2) 全球领先半导体情况

3.1.4 中国半导体行业发展概况

3.1.5 半导体设备BB值分析

3.1.6 半导体行业景气预测

3.1.7 半导体行业发展趋势

- (1) 产业链分工是方向
- (2) 综合厂商向轻资产转型
- (3) 封装环节产值逐年成长
- (4) 封装环节外包也是趋势

3.2 集成电路封装行业发展分析

3.2.1 集成电路封装行业规模分析

3.2.2 集成电路封装行业发展现状分析

3.2.3 集成电路封装行业利润水平分析

3.2.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较

3.2.5 集成电路封装行业影响因素分析

- (1) 有利因素
- (2) 不利因素

3.2.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测

- (1) 发展趋势分析
- (2) 前景预测

3.3 集成电路封装类专利分析

3.3.1 专利分析样本构成

- (1) 数据库选择
- (2) 检索方式

3.3.2 封装类专利分析

- (1) 专利公开年度趋势
 - (2) 国内外专利公开趋势对比
 - (3) 国内专利公开主要省市分布
 - (4) IPC技术分类趋势分布
 - (5) 主要权利人分布情况
- 3.4 集成电路封装过程部分技术问题探讨
- 3.4.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策
- (1) 封装开裂的影响因素分析
 - (2) 管控影响开裂的因素的方法分析
- 3.4.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策
- (1) 产生芯片弹坑问题的因素分析
 - (2) 预防芯片弹坑问题产生的方法
- 第四章：中国集成电路封装行业市场需求分析
- 4.1 集成电路市场分析
- 4.1.1 集成电路市场规模
- 4.1.2 集成电路市场结构分析
- (1) 集成电路市场产品结构分析
 - (2) 集成电路市场应用结构分析
- 4.1.3 集成电路市场竞争格局
- 4.1.4 集成电路国内市场自给率
- 4.1.5 集成电路市场发展预测
- 4.2 集成电路封装行业需求分析
- 4.2.1 计算机领域对行业的需求分析
- (1) 计算机市场发展现状
 - (2) 集成电路在计算机领域的应用
 - (3) 计算机领域对行业需求的拉动
- 4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析
- (1) 消费电子市场发展现状
 - (2) 集成电路在消费电子领域的应用
 - (3) 消费电子领域对行业需求的拉动
- 4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析
- (1) 通信设备市场发展现状
 - (2) 集成电路在通信设备领域的应用
 - (3) 通信设备领域对行业需求的拉动
- 4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析

- (1) 工控设备市场发展现状
- (2) 集成电路在工控设备领域的应用
- (3) 工控设备领域对行业需求的拉动
- 4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析
 - (1) 汽车电子市场发展现状
 - (2) 集成电路在汽车电子领域的应用
 - (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动
- 4.2.6 其他应用领域对行业的需求分析
- 第五章：中国集成电路封装行业市场竞争分析
- 5.1 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析
 - 5.1.1 现有竞争者之间的竞争
 - 5.1.2 关键要素的供应商议价能力分析
 - 5.1.3 消费者议价能力分析
 - 5.1.4 行业潜在进入者分析
 - 5.1.5 替代品风险分析
- 5.2 集成电路封装行业国际竞争格局分析
 - 5.2.1 国际集成电路封装市场总体发展状况
 - 5.2.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析
 - 5.2.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析
 - (1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本
 - (2) 主板材料的变化趋势
 - 5.2.4 跨国企业在华市场竞争力分析
 - (1) 台湾日月光集团竞争力分析
 - 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
 - (2) 美国安靠 (Amkor) 公司竞争力分析
 - 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
 - (3) 台湾矽品公司竞争力分析

- 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
 - (4) 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析
 - 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
 - (5) 力成科技股份有限公司竞争力分析
 - 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
 - (6) 飞思卡尔公司竞争力分析
 - 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
 - (7) 英飞凌科技公司竞争力分析
 - 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
- 5.3 集成电路封装行业国内竞争格局分析
- 5.3.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析
 - 5.3.2 国内集成电路封装行业集中度分析
 - (1) 行业销售收入集中度分析
 - (2) 行业利润集中度分析
 - (3) 行业工业总产值集中度分析

5.3.3国内集成电路封装行业国际竞争力分析

第六章：中国集成电路封装行业产品市场分析

6.1集成电路封装行业BGA产品市场分析

6.1.1BGA封装技术水平

6.1.2BGA产品主要应用领域

6.1.3BGA产品需求拉动因素

6.1.4BGA产品市场规模分析

6.1.5BGA产品市场前景展望

6.2集成电路封装行业SIP产品市场分析

6.2.1SIP封装技术水平

6.2.2SIP产品主要应用领域

6.2.3SIP产品需求拉动因素

6.2.4SIP产品市场规模分析

6.2.5SIP产品市场前景展望

6.3集成电路封装行业SOP产品市场分析

6.3.1SOP封装技术水平

6.3.2SOP产品主要应用领域

6.3.3SOP产品市场发展现状

6.3.4SOP产品市场前景展望

6.4集成电路封装行业QFP产品市场分析

6.4.1QFP封装技术水平

6.4.2QFP产品主要应用领域

6.4.3QFP产品市场发展现状

6.4.4QFP产品市场前景展望

6.5集成电路封装行业QFN产品市场分析

6.5.1QFN封装技术水平

6.5.2QFN产品主要应用领域

6.5.3QFN产品市场发展现状

6.5.4QFN产品市场前景展望

6.6集成电路封装行业MCM产品市场分析

6.6.1MCM封装技术水平概况

(1) 概念简介

(2) MCM封装分类

6.6.2MCM产品主要应用领域

6.6.3MCM产品需求拉动因素

6.6.4MCM产品市场发展现状

6.6.5MCM产品市场前景展望

6.7集成电路封装行业CSP产品市场分析

6.7.1CSP封装技术水平概况

(1) 概念简介

(2) CSP产品特点

(3) CSP封装分类

(4) CSP封装工艺流程

6.7.2CSP产品主要应用领域

6.7.3CSP产品市场发展现状

6.7.4CSP产品市场前景展望

6.8集成电路封装行业其他产品市场分析

6.8.1晶圆级封装市场分析

(1) 概念简介

(2) 产品特点

(3) 主要应用领域

(4) 市场规模与主要供应商

(5) 前景展望

6.8.2覆晶/倒封装市场分析

(1) 概念简介

(2) 产品特点

(3) 市场前景

6.8.3 3D封装市场分析

(1) 概念简介

(2) 封装方法

(3) 发展现状与前景

第七章：中国集成电路封装行业主要经营分析

7.1集成电路封装企业发展总体状况分析

7.1.1集成电路封装行业制造商工业总产值排名

7.1.2集成电路封装行业制造商销售收入排名

7.1.3集成电路封装行业制造商利润总额排名

7.2集成电路封装行业领先企业个案分析

7.2.1飞思卡尔半导体（中国）有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产销能力分析

(3) 企业经营分析

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

(4) 企业产品结构及新产品动向

(5) 企业销售渠道与网络

(6) 企业经营状况优劣势分析

7.2.2 威讯联合半导体（北京）有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 主要经济指标分析

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

(3) 企业产销能力分析

(4) 企业产品结构及新产品动向

(5) 企业销售渠道与网络

(6) 企业经营状况优劣势分析

7.2.3 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 主要经济指标分析

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

(3) 企业组织架构分析

(4) 企业产品结构及新产品动向

(5) 企业销售渠道与网络

(6) 企业经营状况优劣势分析

(7) 企业投资、兼并与重组分析

(8) 企业最新发展动向分析

7.2.4 上海松下半导体有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产销能力分析

(3) 主要经济指标分析

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

(4) 企业产品结构及新产品动向

(5) 企业销售渠道与网络

7.2.5深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产销能力分析

(3) 主要经济指标分析

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

(4) 企业产品结构及新产品动向

(5) 企业销售渠道与网络

(6) 企业经营状况优劣势分析

(7) 企业最新发展动向分析

第八章：中国集成电路封装行业投资分析及建议

8.1集成电路封装行业投资特性分析

8.1.1集成电路封装行业投资壁垒

(1) 技术壁垒

(2) 资金壁垒

(3) 人才壁垒

(4) 严格的客户认证制度

8.1.2集成电路封装行业盈利模式

8.1.3集成电路封装行业盈利因素

8.2集成电路封装行业投资兼并与重组分析

8.2.1集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

8.2.2国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

8.2.3国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

(1) 通富微电公司投资兼并与重组分析

(2) 华天科技公司投资兼并与重组分析

(3) 长电科技公司投资兼并与重组分析

8.2.4集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

8.3集成电路封装行业投融资分析

8.3.1电子发展基金对集成电路产业的扶持分析

(1) 电子发展基金对集成电路产业的扶持情况

(2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

8.3.2集成电路封装行业融.资成本分析

8.3.3半导体行业资本支出分析

8.4集成电路封装行业投.资建议

8.4.1集成电路封装行业投.资机会分析

8.4.2集成电路封装行业投.资风险分析

8.4.3集成电路封装行业投.资建议

(1) 投.资区域建议

(2) 投.资产品建议

(3) 技术升级建议

图表详见正文.....

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/232624232624.html>